



牛人已开启手机号隐私保护

您可使用BOSS直聘APP扫描二维码联系Ta

1f60ab27bbd120741HNz09q1EVVVxlS7Wf2cW0OnaffXMRlr



朱斌

男 | 37岁 472433079@qq.com

15年工作经验 | 求职意向：机械结构工程师 | 期望薪资：30-35K | 期望城市：深圳

个人优势

- >对待工作积极认真负责，工作态度端正。
- >学习能力强，思维活跃，工作经验丰富。
- >熟悉产品开发设计流程。熟悉塑胶，硅胶，五金，铝材等材质的加工工艺及表面处理工艺，对模具有一定的了解。
- >熟悉曲面建模，有过 ID 经验，可以出渲染效果图。
- >熟悉公差分析，尺寸链计算，有较强的分析并处理问题能力。
- >多种尺寸触屏类产品整机结构设计经验，了解 LCD 模组结构。
- >有50米（5ATM）防水设计经验。
- >会有限元分析力学仿真，电子产品散热仿真。
- >有小团队管理经验。
- >有国外大客户服务经验。
- >主导结构方案和细节设计，具备独当一面能力。

工作经历

深圳市360智慧生活科技有限公司 结构专家 2025.11-至今

在该公司主要负责360行车记录仪类产品线的整机结构设计和开模及试产跟进。

- 1: 参与前期立项会议，ID 评审，风险评估
- 2: 负责电子元件堆叠，根据 ID 优化结构
- 3: 负责3D图纸设计，2D图纸输出，包含结构件壳料支架等，线材，FPC等，电子结构料摄像头喇叭，mic，板框图，拼板图，限高图等，产品 BOM 输出，协助采购评估成本
- 4: 手板打样，结构试装与摸底测试，与 ID 和项目一起确认产品结构
- 5: 产品开模，与供应商进行技术对接，模具 DFM 评审，释放开模图纸
- 6: 试模跟进，试模问题点追踪，关闭问题点后签样承认，CPK 图纸释放，与品质交接注意事项
- 7: DVT 试产跟进，改善试产问题，协助 PE 制作 SOP
- 8: 配合品质部门进行相关可靠性测试
- 9: PVT 试产跟进，关闭问题点后量产，最终样品承认，封样

部门：产品创新中心

在该公司主要负责平板音响类，智能穿戴类产品的整机结构设计和开模及试产跟进，主要服务国外大客户ODM产品开发

- 1：参与前期立项会议，ID 评审，风险评估
- 2：负责电子元件堆叠，根据 ID 优化结构，输出TA公差分析报告给客户，Design review report。
- 3：负责3D图纸设计，2D图纸输出，包含结构件壳料支架等，线材，FPC等，电子结构料摄像头喇叭，mic，板框图，拼板图，限高图等，产品 BOM 输出，协助采购评估成本
- 4：手板打样，结构试装与摸底测试，与 ID 和项目一起确认产品结构
- 5：产品开模，与供应商进行技术对接，模具 DFM 评审，释放开模图纸
- 6：试模跟进，试模问题点追踪，关闭问题点后签样承认，CPK 图纸释放，与品质交接注意事项
- 7：DVT 试产跟进，进行产品失效分析，输出失效分析及后续优化方案报告给客户，设计DOE方案验证改善试产问题，协助 PE 制作 SOP
- 8：配合品质部门进行相关可靠性测试
- 9：PVT 试产跟进，关闭问题点后量产，最终样品承认，封样

部门：产品研发部

在该公司主要负责汽车诊断类产品的整机结构设计和跟进，包含汽车诊断平板，手持检测设备，汽车钥匙，胎压传感器等产品，有简单的静力学仿真，有限元分析经验。

- 1：参与前期立项会议，ID 评审，风险评估
- 2：负责电子元件堆叠，根据 ID 优化结构
- 3：负责3D图纸设计，2D图纸输出，包含结构件壳料支架等，线材，FPC等，电子结构料摄像头喇叭，mic，板框图，拼板图，限高图等，产品 BOM 输出，协助采购评估成本
- 4：首板打样，结构试装，与 ID 和项目一起确认产品结构
- 5：产品开模，与供应商进行技术对接，模具 DFM 评审，释放开模图纸
- 6：试模跟进，试模问题点追踪，关闭问题点后签样承认，CPK 图纸释放，与品质交接注意事项
- 7：DVT 试产跟进，改善试产问题，协助 PE 制作 SOP
- 8：配合品质部门进行相关可靠性测试
- 9：PVT 试产跟进，关闭问题点后量产，最终样品承认，封样

部门：硬件研发部

在该公司主要负责智能家居类产品的整机结构设计和跟进，包含智能中控屏，门口对讲机，智能门锁类产品，有 mic气密性，语音对讲，语音唤醒识别设计经验

- 1：参与前期立项会议，ID 评审，风险评估
- 2：负责电子元件堆叠，根据 ID 优化结构
- 3：负责3D图纸设计，2D图纸输出，包含结构件壳料支架等，线材，FPC等，电子结构料摄像头喇叭，mic，板框图，拼板图，限高图等，产品 BOM 输出，协助采购评估成本
- 4：首板打样，结构试装，与 ID 和项目一起确认产品结构
- 5：产品开模，与供应商进行技术对接，模具 DFM 评审，释放开模图纸
- 6：试模跟进，试模问题点追踪，关闭问题点后签样承认，CPK 图纸释放，与品质交接注意事项
- 7：DVT 试产跟进，改善试产问题，协助 PE 制作 SOP
- 8：配合品质部门进行相关可靠性测试
- 9：PVT 试产跟进，关闭问题点后量产，最终样品承认，封样

部门：硬件研发部

在该公司主要负责信息安全和生物识别终端产品的整机结构设计和跟进，包含手持智能终端（PDA 手机带4G），平板类，桌面式终端，壁挂式终端产品，移动支付类产品，安防门禁类产品，有 ip66防水设计经验

- 1：参与前期立项会议，ID 评审，风险评估
 - 2：负责电子元件堆叠，根据 ID 优化结构
 - 3：负责3D图纸设计，2D图纸输出，包含结构件壳料支架等，线材，FPC等，电子结构料摄像头喇叭，mic，马达等，板框图，拼板图，限高图等，产品 BOM 输出，协助采购评估成本
 - 4：首板打样，结构试装，与 ID 和项目一起确认产品结构
 - 5：产品开模，与供应商进行技术对接，模具 DFM 评审，释放开模图纸
 - 6：试模跟进，试模问题点追踪，关闭问题点后签样承认，CPK 图纸释放，与品质交接注意事项
 - 7：DVT 试产跟进，改善试产问题，协助 PE 制作 SOP
 - 8：配合品质部门进行相关可靠性测试
 - 9：PVT 试产跟进，关闭问题点后量产，最终样品承认，封样
- 部门：智能终端研发中心

在该公司主要负责教育类平板，数字班牌及周边产品的结构设计和跟进

- 1：参与前期立项会议，ID 评审，风险评估
- 2：负责电子元件堆叠，根据 ID 优化结构
- 3：负责3D图纸设计，2D图纸输出，产品 BOM 输出，协助采购评估成本
- 4：首板打样，结构试装，与 ID 和项目一起确认产品结构
- 5：产品开模，与供应商进行技术对接，模具 DFM 评审，释放开模图纸
- 6：试模跟进，试模问题点追踪，关闭问题点后签样承认，CPK 图纸释放，与品质交接注意事项
- 7：DVT 试产跟进，改善试产问题，协助 PE 制作 SOP
- 8：配合品质部门进行相关可靠性测试
- 9：PVT 试产跟进，关闭问题点后量产，最终样品承认，封样
- 10：对已经量产的机型进行维护，costdown 方案设计
- 11：规范研发流程，新人培养

在该公司主要负责电子产品外观及结构设计，包涵移动电源，智能网关，路由器等

- 1：根据客户需求，提出概念设计
- 2：绘制初步效果图及 CMF 文件与客户确认
- 3：确认后3D建模和结构设计
- 4：首板样品试装，确认结构可行性
- 5：依据客户需求优化变更，产品整机尺寸图，爆炸图等资料输出

在该公司主要负责笔记本电脑外观设计。

- 1：搜集电子产品前沿信息，市场调研
- 2：与组员头脑风暴，进行概念设计，草图绘制
- 3：确认产品 CMF，渲染效果图及产品3D动画制作
- 4：ID 评审确认后3D曲面建模（使用 PROE）
- 5：拆件，与结构沟通后做出相应壁厚的壳体

- 6：生产文件制作，丝印图，包装印刷等
- 7：跟进试模，对于外观 issue 改善，确认后对外观样品签样

教育经历

西华大学	本科	机械电子工程	2007-2011
------	----	--------	-----------

资格证书

大学英语四级